

消费电子概念股，业绩持续增长，一季度利润超预期

摘要：AI 服务器和 AI PC 业务为公司带来新的增量。

作者：市值风云 App：天成 henry

公司近期看点：

- 1、一季度业绩回升态势显著。
- 2、近期融资买入情况非常活跃。

以下为付费部分（不可见）

一、公司简介及业绩情况

景旺电子成立于 1993 年，深耕印制电路板行业，是专业从事印制电路板研发、生产和销售的企业，目前公司在国内拥有广东深圳、广东龙川、江西吉水、珠海金湾、珠海富山五大生产基地共 11 个工厂。

公司产品覆盖多层板、厚铜板、高频高速板、金属基电路板、双面/多层柔性电路板、高密度柔性电路板、HDI 板、刚挠结合板、特种材料 PCB、类载板及 IC 载板等。公司产品广泛应用于新一代信息技术、汽车电子、通信设备、消费电子、计算机及网络设备、工业控制、安防等领域。

应用领域	公司产品	主要设备	对应产品名称	特征	
汽车电子	PCB	毫米波雷达、摄像头、激光雷达、信息娱乐系统、照明系统、ADCU、新能源充配电、电驱等	高频微波板、软硬结合板、厚铜板、金属基板等	高频材料混压、高可靠性、HDI、软硬结合、半软板，多层板、厚铜、埋嵌铜、铜基、铝基板	
	FPC	车载信息娱乐系统、高级驾驶辅助系统、车身电子系统、BMS	单双面 FPC、RFPC、大尺寸 FPC、厚铜 FPC、镂空 FPC、FDC	高挠曲性、高可靠性（高温高压）、大电流、软硬结合、高速数据传输，CCS、大尺寸、厚铜、保险丝、镂空，铜基、铝基板	
工控医疗	PCB	工控、医疗系统	高多层板	高可靠性、多层板、软硬结合	
	FPC	工业自动化设备、电力控制系统、无人机、电子烟、医疗监测仪器、医疗器械、植入式医疗设备	FPC、RFPC、FPC、RFPC，LCP、MPI、PTFE	高可靠性、动态连接、软硬结合、高频高速，高挠曲、应用环境复杂	
消费电子	PCB	手机、穿戴、耳机、笔记本	HDI	Anylayer、高密度、轻薄、精细线路，高盲孔可靠性	
	FPC	手机、ARVR、耳机笔记本	分层 FPC、RFPC、Anylayer、多层高阶、OLED，LCP、MPI、PTFE	高频高速、高挠曲性、轻薄，高多阶、Anylayer、高密度、精细线路，填孔、埋孔、微小孔	
数据中心	PCB	交换机、服务器、存储设备	背板、高速多层、AI 加速卡、DDR	高速材料、高多层、大尺寸、高密度、多种背板、插损管控、金手指	
通信	有线	PCB	交换路由、光纤设备等（PON\OTN\OLT）	背板、高速多层、高频微波、光模块	高速材料，大尺寸、高多层、高密度、mSAP、多种背钻、高速材料混压、金手指
	无线		通信基站、卫星通信、低轨卫星互联网通信	背钻、高速多层板、高频微波板、多功能金属基板、埋阻、空气腔板	金属基、大尺寸、多种背钻、高多层、高频高速材料混压，不对称结构
其他	家电等	FPC	智能电视机、智能音响、智能家居控制系统	FPC、OLED、RFPC	轻薄、高速、高效

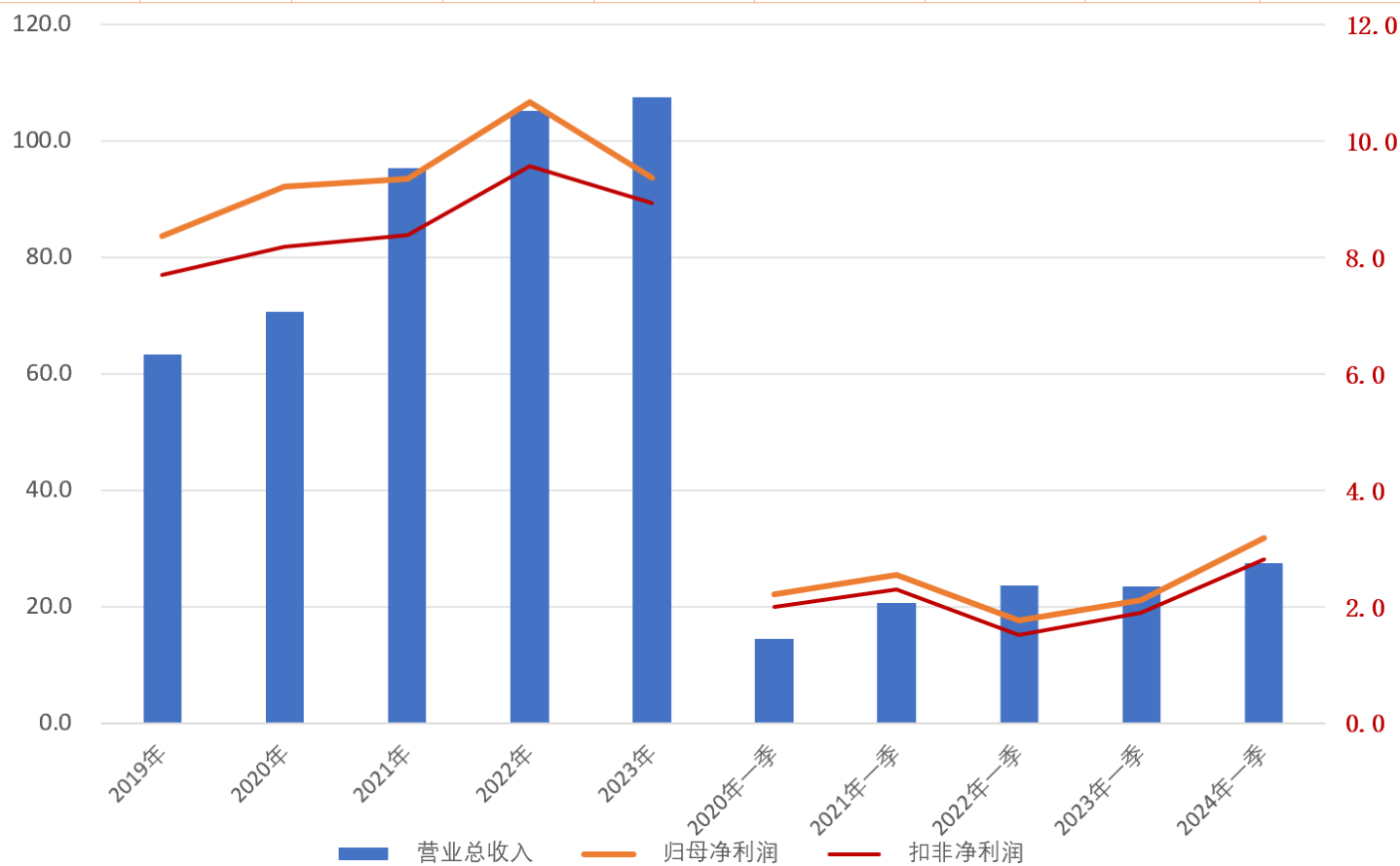
（公司产品重点应用领域）

2023 年电子行业整体需求下行，导致 PCB 需求下滑，据 Prismark 数据，2023 年全球 PCB 产值同比下降 15%至 695.2 亿美元。景旺电子 2023 年实现营收 107.6 亿元，同比增长 2.31%；归母净利润 9.4 亿元，同比下降 12.2%，扣非净利润 8.9 亿元，同比下降 6.8%。

2024 年第一季度，下游需求整体有一定复苏，其中汽车和消费类同比增长较多，公司一季度实现营业收入 27.4 亿元，较上年同期上升 17.2%；实现归母净利润 3.2 亿元，较上年同期上升 50.3%；扣非净利润 2.8 亿元，较上年同期上升 48.3%。一季度利润回升态势明显，创 2020 年来第一季度最高水平。

景旺电子业绩变动情况（亿元）

项目	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2020年一季	2021年一季	2022年一季	2023年一季	2024年一季
营业总收入	63.3	70.6	95.3	105.1	107.6	14.4	20.7	23.7	23.4	27.4
归母净利润	8.4	9.2	9.4	10.7	9.4	2.2	2.5	1.8	2.1	3.2
扣非净利润	7.7	8.2	8.4	9.6	8.9	2.0	2.3	1.5	1.9	2.8



(数据来源: Choice 金融终端, 制图: 市值风云 APP)

据 prisma 统计, 服务器存储设备领域、汽车领域 PCB 增速将分别以 9.2%、5.07% 的复合增长率增长, 成为未来五年内增长最快的细分产品应用领域之一。按产品结构细分, 增速较快的有封装基板、18 层及以上的高多层板、HDI 板, 未来五年复合增速分别为 8.8%、7.8%、6.2%。

公司产品多样, 汽车 PCB 业务占比已经达到营收的 30-40%, 公司的汽车 PCB 覆盖了汽车电子几乎绝大多数的零部件产品包括智能座舱, 三电系统, 激光雷达等等。此外, 公司产品中高阶 HDI/Any-layer, 软硬结合板、软板、类载板、载板等可应用于 AI phone 和 AI PC, 其高多层、HDI、SLP 等产品可用于存储芯片/模组及数据中心。

二、涉及概念

- 1、PCB 概念: 公司专注于印制电路板行业, 主要从事印制电路板的研发、生产和销售。
- 2、汽车电子: 公司子公司江西景旺具有较强的规模化制造能力, 主要定位于汽车电子, 在汽车电子领域, 海拉、科世达、德赛西威、法雷奥等国内外知名汽车电子企业已成为公司的主要客户。
- 3、无人驾驶: 在无人驾驶应用领域, 公司的高阶 HDI 产品可用于汽车域控制器包括座舱域控制器、车身域控制器、底盘域控制器和 ADAS 域控制器等, 还包括感知层面的摄像头及毫米波雷达、激光雷达等, 目前下游客户为国内外 tier1 零部件商及整车厂。
- 4、卫星导航: 公司已为国内外客户批量供货低轨卫星通信用 PCB 板, 低轨卫星组网建设可提供不受地形限制的大范围覆盖, 有利于补充 5G 通信基站建设的空白, 未来 6G 时代低轨卫星建设和移动通信技术相融合, 将使得智慧城市、车联网、远程医疗等新兴技术的实现成为可能。
- 5、华为概念: 华为是公司的重要战略客户, 公司已经向客户供应通信、服务器、数字能源、车载及终端消费类等应用领域产品。
- 6、英伟达概念: 公司与英伟达在算力、自动驾驶、显卡等领域均有深度合作。

三、事件催化

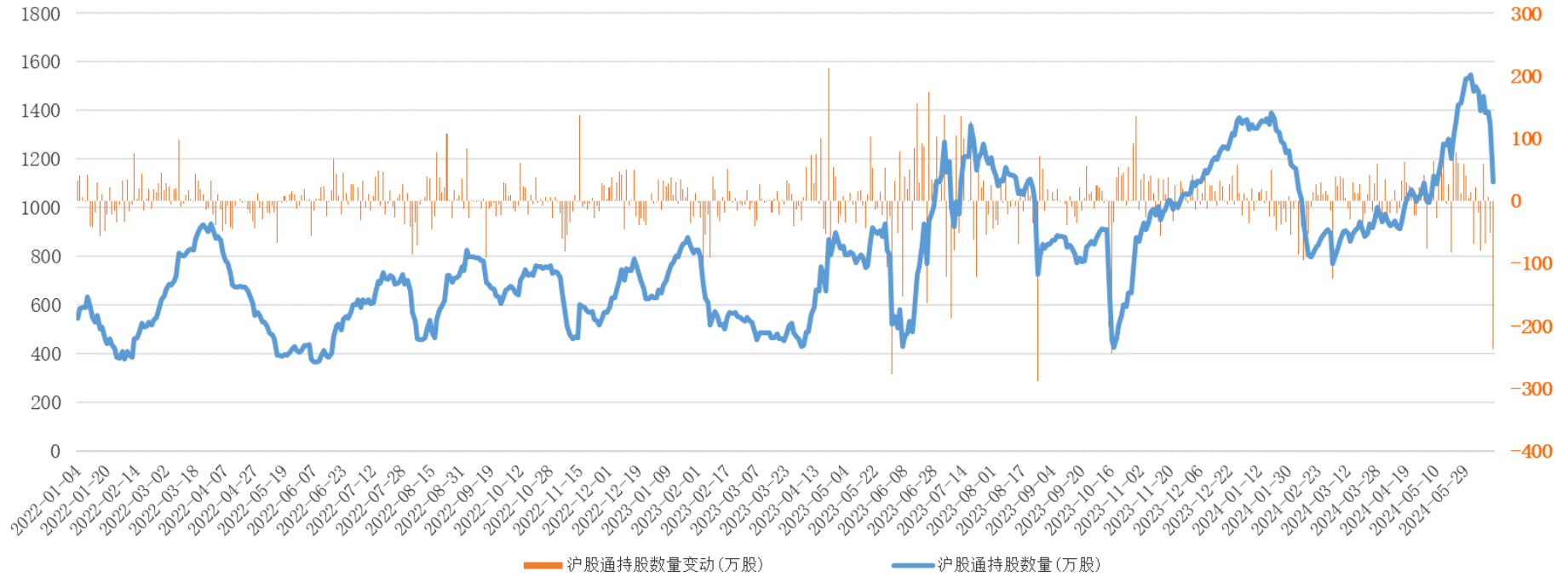
1、PCB 概念近期受到英伟达的带动。有观点表示，英伟达 GB200 的服务器下半年正式放量，AI 服务器 PCB 主要新增在 GPU 板组。同时 AI 服务器对传输速率要求较高，需要用到 20-30 层的 HDI 板，而且在材料选择上会用到超低损耗材料，其价值量进一步提升。

2、机构表示，从订单预期和出货逐月变化情况来看，全球 PCB 行业景气度呈现上行趋势。数据显示，北美 PCB 订单出货比已连续 3 个月在 1 以上，2024 年 4 月订单额和出货量当月同比同时实现正增长。展望 2024 年，伴随全球半导体周期复苏态势及以苹果 XR、AI PC 等为代表的终端创新推出，行业“周期+成长”双重逻辑有望持续共振。

四、市场行为

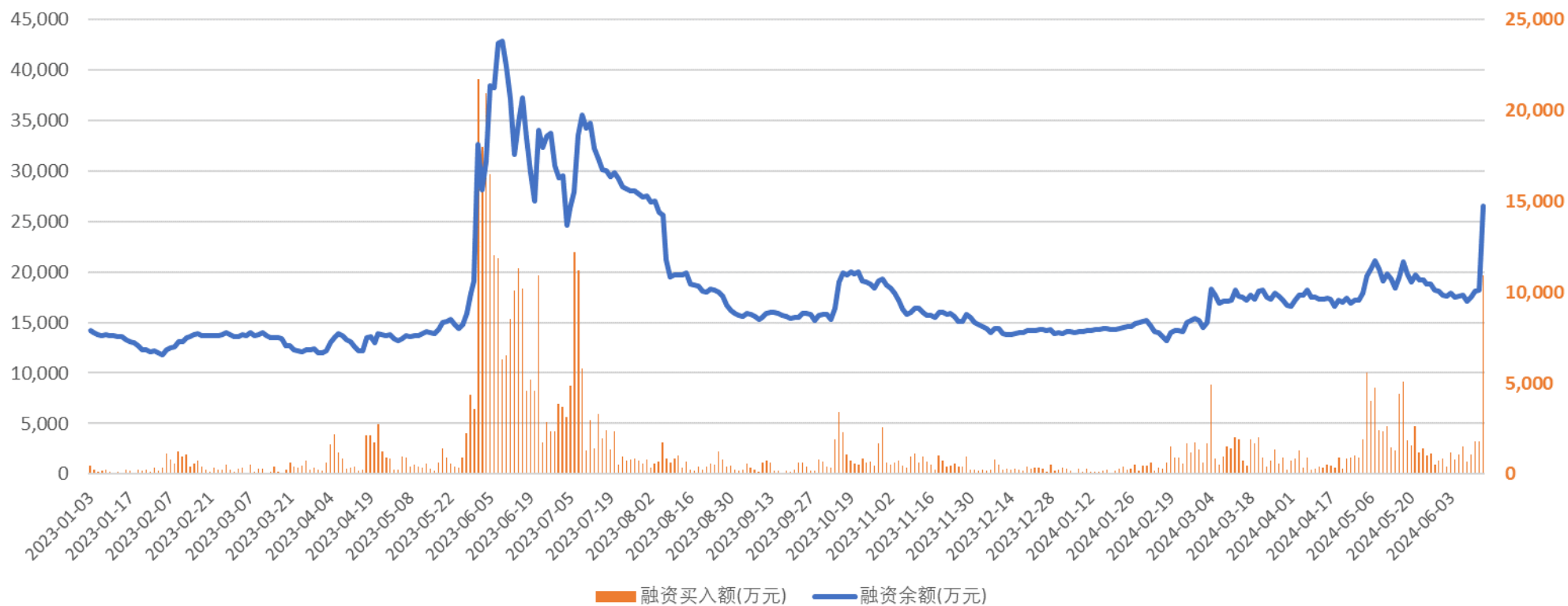
3 月以来“北向资金”持续加仓景旺电子，不过近期“北向资金”有所流出，沪股通持股数量有所降低。

“北向资金”持仓景旺电子变动情况



(数据来源: Choice 金融终端, 制图: 市值风云 APP)

近期景旺电子融资买入情况非常活跃, 融资买入额和融资余额急剧上升。



(数据来源: Choice 金融终端, 制图: 市值风云 APP)

景旺电子前十大流通股股东持股比例较高, 接近 80%, 2024 年一季度公司前十大流通股股东持股比例变化不大。

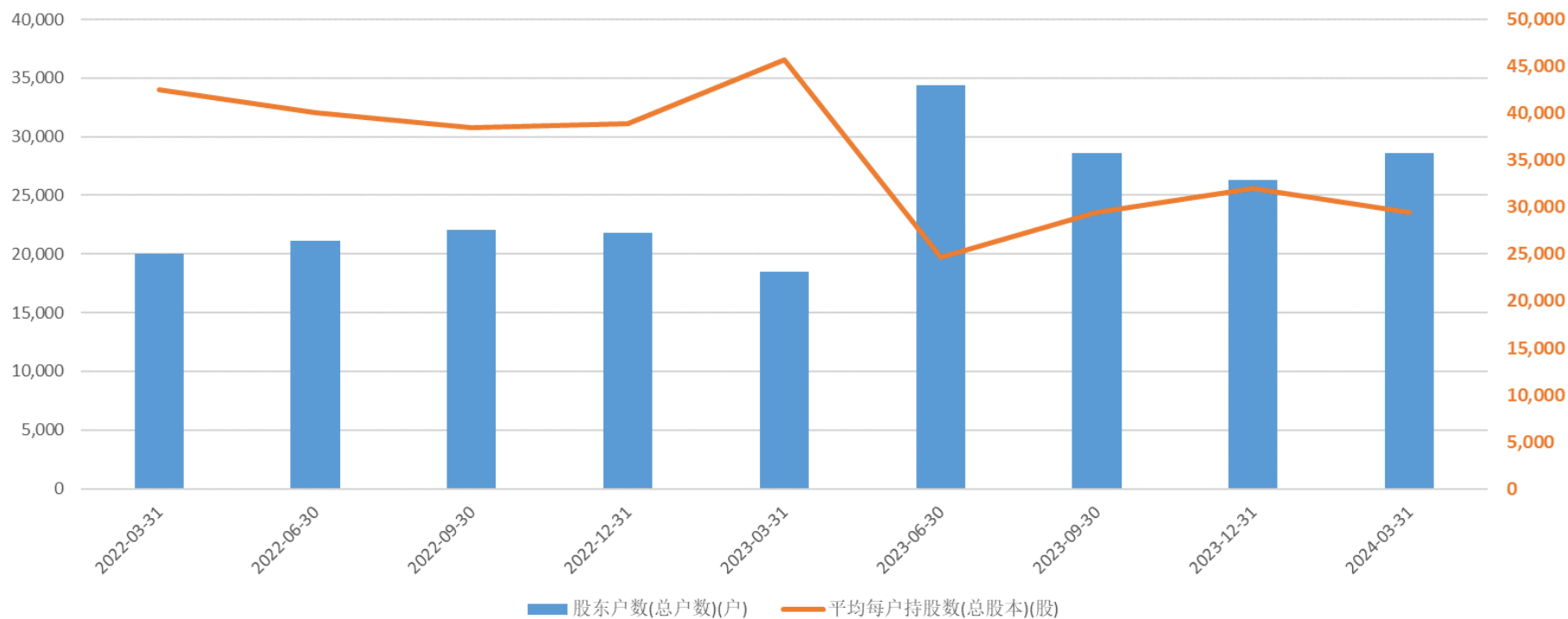
2024一季度景旺电子前十大流通股股东持仓情况

股东名称	股东性质	持股数量 (万股)	占总股本比例 (%)	占无限售流通股 比例 (%)	较上期持股变动数 (万股)
深圳市景鸿永泰投资控股公司	投资公司	29,373.1	34.9	34.9	不变
智創投资有限公司	投资公司	29,373.1	34.9	34.9	不变
深圳市皓润软件开发公司	其它	1,976.8	2.3	2.3	不变
雷习英	个人	1,174.9	1.4	1.4	不变
香港中央结算有限公司	其它	1,002.0	1.2	1.2	-353.9
工银瑞信创新动力股票基金	基金	933.0	1.1	1.1	不变
全国社保基金四一三组合	社保基金	672.0	0.8	0.8	45.0
赖哲	个人	607.1	0.7	0.7	19.0
工银瑞信精选平衡混合基金	基金	435.0	0.5	0.5	39.0
中证500ETF	基金	358.8	0.4	0.4	新进
合计		65,905.7	78.3	78.3	

(数据来源: Choice 金融终端, 制图: 市值风云 APP)

一季度公司股东数略微上升, 平均每户持股数略微下降。

景旺电子股东户数变动情况



(数据来源: Choice 金融终端, 制图: 市值风云 APP)